

## 信頼性試験結果 Reliability Test

XC6702D シリーズ

XC6702D Series

パッケージ

SOT-89-5

RoHS対応品 / RoHS Compliance

ハロゲン&amp;アンチモンフリー / Halogen &amp; Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=38V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=38V	1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle	-65°C~150°C 各30分 30min each	100CYC.	0/22
5	プレッシャークッカーバイアス HAST	125°C85%RH 2×10 <sup>5</sup> Pa VIN=38V	100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020	-	0/22
7	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM R=0Ω C=200pF ±200V以上 R=0Ω C=200pF ±200V over	3回 3 times	0/5
		HBM R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 R=1500Ω C=100pF ±1kV over	3回 3 times	0/5
		CDM ±500V以上 ±500V over	3回 3 times	0/5
8	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上 R=0Ω C=200pF ±100V over	3回 3 times	0/5
		50mA以上 50mA over	3回 3 times	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	端子引っ張り Terminal Strength	1N 10秒 1N 10s	0/5
2	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 230°C 10s (Temperature profile method)	0/11